

FED

● — Wir verbinden

Ausschreibung und Bewerbungsunterlagen



pcb AWARD '26
design



<https://www.pcb-design-award.de>

Der PCB Design Award

Der PCB Design Award ist ein Berufswettbewerb für Baugruppendesigner im deutschsprachigen Raum. Anlässlich der Jahreskonferenz am 23.-24. September 2026 in Bamberg ehrt der Fachverband Elektronikdesign und -fertigung (FED) zum achten Mal Baugruppendesigner in vier Kategorien.

Dazu ruft der FED alle Baugruppendesigner auf, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten an einem Design vorzustellen und sich für den PCB Design Award zu bewerben. Die Einladung richtet sich an alle Designer, unabhängig von einer Mitgliedschaft im FED.

Alle Nominierten erhalten eine Sieger- bzw. Nominierten-Urkunde und damit eine hohe berufliche Anerkennung.

Durch den PCB Design Award wird der Beruf der Baugruppendesigner in der Öffentlichkeit bekannter.

Baugruppendesigner sind die zentrale Schnittstelle zwischen Entwicklung und Fertigung. Sie koordinieren Anforderungen aus Schaltungsdesign, Produktion, Bestückung und Prüfung – und beeinflussen maßgeblich Kosten und Qualität der späteren Herstellung. Der PCB Design Award würdigt diese zunehmend bedeutende Rolle.

Fachverband Elektronikdesign und -fertigung (FED)

Die Verleihung des PCB Design Awards durch den FED liegt denkbar nah. Der FED wurde im Jahr 1992 als Fachverband Elektronik-Design e.V. gegründet und vertrat zunächst die Interessen der Leiterplatten-Designerinnen und -Designer. Heute ist der FED ein Partner für alle, die in Entwicklung und Produktion von Elektronik involviert sind.

In seiner Verbandsarbeit hat der FED ein mehrstufiges Aus- und Weiterbildungskonzept für Baugruppendesigner in der Berufspraxis entwickelt. Den Abschluss dieser Qualifikation bildet die Prüfung zum **Zertifizierten Elektronik-Designer ZED**. Diese Qualifikation gilt als anerkannte Referenz für den Beruf als Baugruppendesigner. Weitere Angebote sind Fachseminare sowie der jährlich veranstaltete PCB Designer Tag.

Der PCB Design Award wird in vier Kategorien verliehen

3D/Bauraum

In dieser Kategorie geht es um mechanische Herausforderungen, die nur mit komplexen, starren, starrflex oder flexiblen Schaltungen gelöst werden können.

High-Power

In dieser Kategorie geht es um die Herausforderungen von sehr hohen Spannungen, Strömen oder Verlustleistungen außerhalb der üblichen Standards und deren Lösungen.

High-Density

In dieser Kategorie dreht sich alles um Schaltungen mit extrem hoher Integrationsdichte oder sehr hohen Übertragungsraten.

Einfach genial

In dieser Kategorie wird „die etwas andere Lösung“ prämiert, die einfach genial oder genial einfach umgesetzt wurde, unabhängig von Trägermaterialien. Das kann zum Beispiel eine simple Lösung sein, die besonders preisgünstig zu fertigen ist, alternative Materialien verwendet oder bei der die Baugruppe recycelbar ist bzw. einen minimalen CO₂-Fußabdruck hinterlässt.

Teilnahmebedingungen

Teilnehmen an der Ausschreibung für den PCB Design Award können alle Baugruppendesigner im deutschsprachigen Raum.

Alle Designer sind eingeladen, sich mit einer oder mehreren Lösungen aus Ihrer Berufspraxis zu bewerben. Für jedes Design muss eine eigene Bewerbung erstellt werden. Jedes Design kann nur für eine Kategorie, die bindend ist, eingereicht werden.

Bewertet wird nur die Realisierung von Schaltungen auf der Basis **eines bestückten Schaltungsträgers**. Von der eingereichten Lösung muss ein funktionsfähiger Prototyp existieren.

Voraussetzung für die Teilnahme am PCB Design Award sind die komplett ausgefüllten **Bewerbungsunterlagen** – siehe Dokument Bewerbungsunterlagen.

In Kapitel 1 und 2 der Bewerbungsunterlagen sind die Teilnehmer aufgefordert, allgemeine und statistische Daten ihres Designs aufzulisten.

In **Kapitel 3** der Bewerbung sind die folgenden Unterlagen erforderlich:

- 3.1** Eine verbale Beschreibung der größten Herausforderungen des vorgelegten Designs
- 3.2** Eine verbale Beschreibung der Lösung der Herausforderung
- 3.3** Ein Foto der komplett bestückten Baugruppe von der Ober- und Unterseite
- 3.4** Screenshots aus verschiedenen Perspektiven und eine verbale Beschreibung, die es möglich machen, das Design ohne Design-Daten zu verstehen

Fotos vorher komprimieren und anpassen.

Wichtig! Es müssen Designparameter und Bilder eingefügt werden.

Einsicht in die Bewerbungsunterlagen haben ausschließlich die Jurymitglieder, die zum Stillschweigen verpflichtet sind (siehe Vertraulichkeitserklärung).

Die Jurymitglieder erhalten die Bewerbungen in anonymisierter Form und bewerten die vorgestellten Lösungen nach festgelegten Kriterien und Punkten.

Das Urteil der Jury ist unanfechtbar.

Die Namen der Sieger des Awards werden nach der Preisvergabe veröffentlicht und ihre Designs in der Fachwelt vorgestellt.

Der Einsendeschluss für die Bewerbung ist der 31. Mai 2026.

Jury

Die Entscheidung über die Preisvergabe fällt innerhalb einer siebenköpfigen Jury. Die Jury setzt sich zusammen aus erfahrenen Baugruppendesignern und Elektronikexperten aus Industrie und Forschung.



Erika Reel ist Mitglied des FED-Vorstands und verantwortet die Bereiche Design und Aus-/Weiterbildung im FED. Nach 7-jähriger Tätigkeit als Leiterplatten-Designerin bei ABB in Turgi war Erika Reel 22 Jahre bei der Firma Omnisec AG in Dällikon, Schweiz, tätig. In der Entwicklung der hochzuverlässigen Nachrichtentechnik hat sie 10 Jahre die Elektronikkonstruktion und 10 weitere Jahre die Elektronik- und Mechanikkonstruktion geleitet.



Robert Berner war bis 2000 Hardwareentwickler und beschäftigt sich seitdem mit dem Design von Baugruppen. Im Rahmen seiner Tätigkeit bei der Firma PRO DESIGN Electronic GmbH hat er vielfältige Erfahrungen gesammelt, insbesondere mit Layouts für High-Speed-Prototyping, Halbleitertestsysteme, Evaluierungskits und Sensorik für die Bereiche Automotive, Raumfahrt, Industrial und Medical. Ein aktueller Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf der Signalintegrität und Simulation auf Baugruppenebene.



Prof. Dr.-Ing Andreas Heinzelmann ist Dozent für Leistungselektronik und Speichersysteme an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft in Winterthur. Durch eine Vielzahl von Projekten mit Industriepartnern auf dem Gebiet der angewandten Forschung hat er Erfahrung in der Konzeption, in der Simulation und im PCB-Design von leistungselektronischen Schaltungen und Industrie-Elektronik sowie in der Mess- und Test-Technik von Baugruppen.



Ralph Heller arbeitet seit 2005 als Hard- und Software-Ingenieur im IBM Forschungslabor in Rüschlikon, Zürich. Er beschäftigt sich mit Design, Bau und Test von Forschungsprototypen und Testsystemen. Ralph Heller betreut den gesamten Prozess des Electronic Designs bis zur Bestückung und Inbetriebnahme der Prototypen. Zudem verantwortet er die Programmierung und das Packaging mit Draht- und Flip-Chip-Bondern.



Michael Matthes ist Mitglied des FED-Vorstands, studierte Elektrotechnik mit Schwerpunkt Telekommunikation an der FH Darmstadt und ist zertifizierter CID, CID+ sowie FED Designer. Nach mehreren Jahren in der Elektronikentwicklung bei WITTENSTEIN SE, wo er sich auf Design und 3D-Simulation spezialisierte, übernahm er die Rolle als Senior Expert für neue Elektroniktechnologien und EDA-Systeme. Seit 2022 arbeitet er als Specialist PCB-Design und Measurement und leitet die Abteilung WEdesign der Würth Elektronik GmbH & Co. KG.



Michael Schleicher hat 30 Jahre Berufserfahrung als Baugruppendesigner. Seit 2008 arbeitet er beim Hersteller von Bauelementen und Systemen für Leistungselektronik Semikron Danfoss in Nürnberg. Für zwei seiner Designlösungen wurde er 2002 mit dem Preis "Most Challenging High Speed Design" und 2012 mit dem FED PCB Design Award in der Kategorie "High Power" ausgezeichnet. Michael Schleicher ist Mitglied des FED-Vorstandes und Leiter des Arbeitskreises Normen und Richtlinien.



Dieter Wachter war 38 Jahre Entwicklungsingenieur bei Diehl Defence in Überlingen. Sein Spezialgebiet war das Design von komplexen Star-Flexiblen und HDI-Leiterplatten sowie Lösungen in Hybrid-Technologie. Seit 2015 ist er beim FED Referent im ZED Level I. Dieter Wachter wurde für seine Arbeit geehrt mit dem 1. Preis des Veribest PCB-Design-Wettbewerbs 1999 und dem EDA-Vendor PCB-Design-Award 2002 (heute: Mentor Leadership Award).

Vertraulichkeitserklärung

Die Juroren sind verpflichtet, alle Informationen vertraulich zu behandeln und haben eine Vertraulichkeitserklärung unterzeichnet.



Vertraulichkeitserklärung

seitens **der Juroren für den PCB Design Award
verliehen vom Fachverband FED e.V.**

über **die im Rahmen des Auswahlverfahrens für die Preisverleihung
bereitgestellten Informationen.**

Jedes Jury-Mitglied verpflichtet sich, die von den Teilnehmern im Rahmen dieses Wettbewerbs schriftlich oder mündlich oder in sonstiger Weise erhaltenen oder bekannt gewordenen Informationen, Kenntnisse oder Erfahrungen sowie die von dem sich bewerbenden Unternehmen/der sich bewerbenden Person ihm bekannt werdende Absichten, Problemstellungen und Problemlösungen auch über die Dauer dieser Vereinbarung hinaus, Dritten gegenüber geheim zu halten.

Diese Verpflichtung gilt nicht für Unterlagen, Kenntnisse und Informationen, die nachweislich allgemein bekannt geworden sind oder ohne Verletzung dieser Vereinbarung später allgemein bekannt werden oder die dem empfangenden Vertragspartner bereits vor Erhalt der Unterlagen, Kenntnisse oder Informationen nachweislich bekannt waren oder ihm ohne Verletzung dieser Vereinbarung später bekannt werden.

Diese Geheimhaltungsverpflichtung endet fünf Jahre nach der jeweiligen Bekanntgabe von Unterlagen, Kenntnissen und Informationen.

Dieser Vertrag unterliegt ausschließlich der Geltung deutschen Rechts. Gerichtsstand ist Berlin.

Salenstein
Ort

15.07.2024
Datum

Erika Reel
Erika Reel

Salenstein
Ort

15.07.2024
Datum

Robert Berner
Robert Berner

Salenstein
Ort

15.07.2024
Datum

Prof. Dr.-Ing Andreas Heinzelmann
Prof. Dr.-Ing Andreas Heinzelmann

Salenstein
Ort

15.07.2024
Datum

Ralph Heller
Ralph Heller

CH - Salenstein
Ort

15.07.2024
Datum

Michael Schleicher
Michael Schleicher

CH-Salenstein
Ort

15.07.2024
Datum

Dieter Wachter
Dieter Wachter

Ulm
Ort

19.08.24
Datum

Michael Matthes
Michael Matthes

Auszeichnungen

Die Gewinner der Award-Kategorien werden am 23.-24. September 2026 während der FED-Konferenz in Bamberg bekannt gegeben.

Der FED nominiert je Kategorie bis zu drei Finalisten. Alle Nominierten werden zur Preisverleihung auf die FED-Konferenz am 23.-24. September 2026 nach Bamberg eingeladen. Der FED übernimmt die Reisekosten und eine Übernachtung.

Die Gewinner in jeder Kategorie erhalten einen Sieger-Pokal, die Sieger-Urkunde sowie 1.000 EUR.

Außerdem werden die Preisträger werbewirksam auf der Webseite **www.pcb-design-award.de** und anderen Print- und Online-Medien präsentiert. Alle Gewinner dürfen ihre Auszeichnungen selbst werblich nutzen und erhalten zu diesem Zweck das druckfähige Logo des Preises.

Es werden keine 2. und 3. Ränge verliehen.

Alle Nominierten (Nichtpreisträger) erhalten eine **Nominierten-Urkunde** und einen **FED-Seminar-Gutschein**.

Unter **allen anwesenden Teilnehmern** am Wettbewerb werden während der Preisverleihung ein **iPad je Kategorie** verlost.

Alle Teilnehmenden (Nichtpreisträger) erhalten einen **Gutschein im Wert von 100 EUR**.

Der FED freut sich auf eine rege Beteiligung am Wettbewerb und wünscht allen Bewerbern viel Erfolg!

Bewerbung

Für die Teilnahme am PCB Design Award hat die Jury einen Bewerbungsbogen erarbeitet. Anhand dieser Formulare muss jeder Teilnehmer sein Design beschreiben und die gefertigte Prototypen-Baugruppe abbilden.

So bewerben Sie sich für den PCB Design Award 2026

1. Bewerbungsformulare herunterladen oder anfordern

Für Ihre Bewerbung benötigen Sie **zwei beschreibbare PDF-Dateien**:

- Bewerbungsbogen Teil 1
- Bewerbungsbogen Teil 2

Bitte die Dateien erst herunterladen, speichern und dann öffnen. Zum Bearbeiten der Datei ist der Adobe Acrobat Reader erforderlich, den Sie auf [Adobe.com](https://www.adobe.com) kostenfrei erhalten.

Diese Dateien können Sie auch **per E-Mail anfordern** bei pcb-design-award@fed.de.

2. Design anhand der Bewerbungsformulare beschreiben

Stellen Sie anhand des Bewerbungsbogens die Daten zu Ihrem Design zusammen und veranschaulichen Sie diese Informationen mit Bildern in den dafür vorgesehenen Feldern. Bitte laden Sie nur komprimierte Fotos in die PDF-Datei. Passen Sie die Bildformate und die Bildgröße an, bevor Sie die Bilder in die beschreibbare PDF-Datei laden.

Entfernen Sie Firmenlogos, Firmennamen und Produktnamen und verzichten Sie in den beschreibenden Texten darauf. Diese Anonymisierung stellt eine neutrale Bewertung Ihrer Arbeit sicher.

3. Ihre Fragen zur Bewerbung

Richten Sie Ihre Anfragen per E-Mail an pcb-design-award@fed.de.

4. Bewerbung einreichen

Senden Sie Ihre Bewerbung bestehend aus dem **Bewerbungsbogen Teil 1 und Teil 2** bis zum **31. Mai 2026 per E-Mail an pcb-design-award@fed.de**.

Sie erhalten eine Eingangsbestätigung.